附表三 產品設計組報名表 ※請用正楷或打字填寫報名表，雙面列印於背面黏貼身分證正反面、學生證正反面影本

**110年度教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」-『產品設計組』報名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申請身分別** | | □學校推薦 □個人申請  □金點新秀設計獎年度最佳設計獎者 | | | | | | | | | | | **申請編號** | | | | ＊本欄由主辦單位填寫，請勿填寫、畫記＊ | | | | | | | | | |
| **姓名/中文** | |  | | | | | | | | | | | **身分證字號** | | | |  | | | | | | | | | |
| **姓名/英文** （同護照格式） | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **性別** | | □男　　□女 | | | | | | | | | | | **出生日期** | | | | 民國　　年　　月　　日 | | | | | | | | | |
| **電子郵件** | | **（務必填寫正確，以後會常以此E-mail聯絡）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **通訊地址** | | □□□-□□**（3+2郵遞區號務必填寫）**  **請提供可收掛號信之地址，以利文件寄送；請勿填宿舍、租屋處等易變動之地址。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **聯絡電話** | | **手機：** | | | | | | | | | | **通訊地址**  **市內電話** | | | | | **住所：** | | | | | | | | | |
| **學**  **歷** | **就讀**  **學校** | **（請填完整學校名稱）** | | | | | | | | | | **推薦教授** | | | | | （如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位） | | | | | | | | | |
| **系所** | **（請填完整系所名稱）** | | | | | | | | | | **推薦教授**  **聯絡電話** | | | | | （如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位） | | | | | | | | | |
| **年級** | 碩士班/大學部 年級 | | | | | | | | | | **推薦教授**  **電子郵件** | | | | | （如為個人申請或金點新秀設計獎年度最佳設計獎者報名免填此欄位） | | | | | | | | | |
| **在學身分備註** | | □**大四確定延畢** □**碩二確定延畢** □**已應屆考取研究所（請檢附錄取文件影本）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **家長或監護人** | |  | | | | | | | | | | **手機號碼** | | | | |  | | | | | | | | | |
| **兵役情形** | | □**已服役** □**免服役** □**尚未服役** □**現役軍人** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **須檢附資料** | | **學校推薦** | | | | | | | **個人申請** | | | | | | | | | | **金點新秀設計獎年度最佳設計獎者** | | | | | | | |
| □ 填寫本報名表紙本  □ 請至網站下載本報名表電子檔（word格式），填寫完畢回傳至idencku@gmail.com  □ 大學（含）以上在學成績單  □ 學校系所推薦公文  □ 老師推薦函  □ 作品集  □ 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單)  □ 其他有助於審查之證明文件與 資料影本 | | | | | | | □ 填寫本報名表紙本  □ 請至網站下載本報名表電子檔（word格式），填寫完畢回傳至idencku@gmail.com  □ 大學（含）以上在校成績單  □ 作品集  □ 語言能力證明影本  □ 其他有助於審查之證明文件與資料影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單)  □ 其他有助於審查之證明文件與 資料影本 | | | | | | | | | | □ 填寫本報名表紙本  □ 請至網站下載本報名表電子檔（word格式），填寫完畢回傳至idencku@gmail.com  □ 作品集  □ 語言能力證明影本(若無語言認證請檢附大學英文相關課程成績單)  □ 其他有助於審查之證明文件與資料影本 | | | | | | | |
| **確認資料**  **申請人簽名** | | 本人已詳閱甄選簡章中之各項規定以及個人資料保護聲明。經由通訊報名之各項資料均為本人親自填報，並確實繳交上述資料，若有不實，願負法律責任並同意被取消錄取資格。  **親筆簽名：**  **填寫日期：　　　年　　　月　　　日** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **請黏貼近三個月內**  **二吋半身脫帽照片**  ※請勿使用生活照、  不得戴有色鏡片之眼鏡 | | | | | |

<報名表請雙面列印>

<報名表請雙面列印>

**------------身分證正面影本黏貼處------------ ------------身分證反面影本黏貼處-----------**

**------------學生證正面影本黏貼處------------ ------------學生證反面影本黏貼處-----------**

個人資料保護聲明

國立成功大學工業設計系為「教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫-產品設計組」之承辦單位（以下稱本組承辦單位)，依據個人資料保護法（以下稱個資法）規定，為保護您的個人資料，於下列事由與目的範圍內，說明本組承辦單位個人資料蒐集、處理及利用告知事項。當您完成報名時，表示您同意以下內容：

1. 個人資料蒐集、處理及利用之目的：本組承辦單位基於教育部菁培獎學金甄選作業以及執行本計畫業務之必要範圍內蒐集、處理及利用您的個人資料。您同意本組承辦單位以您所提供的個人資料確認您的身份、與您進行連絡、提供您本計畫之相關資訊及業務處理，包括後續通知等用途。
2. 個人資料之類別：
   * 1. 基本資料：辨識個人者、政府資料中之辨識者、個人描述等個人資料類別，內容包括姓名、國民身分證統一編號或其他身分證件號碼、出生年月日、性別、電話、電子郵件聯絡資訊等。
     2. 專業技能資料：學校紀錄、資格或技術等個人資料類別。
3. 您同意本組承辦單位於本計畫執行期間利用您個人資料的期間、地區、對象及方式：
   * 1. 期間：除法令另有規定辦理之個人資料保存期限外，以完成上開蒐集、處理及利用之目的或本組承辦單位執行業務所必須之期間為利用期間。
     2. 地區：台灣地區（包括澎湖、金門及馬祖等地區）或其他為完成上開蒐集、處理及利用之目的所必須之地區。
4. 對象：本組承辦單位及本計畫相關人員。方式：以電話、電子郵件、紙本或其他合於當時科技之適當方式作個人資料之利用。
5. 您的個人資料蒐集之目的消失或期限屆滿時，您同意本計畫得繼續保存、處理或利用您的個人資料。除本組承辦單位於專案執行期間因執行職務或業務所必須或為遵循其他法令之規定者外，您可於專案期間隨時向本組承辦單位請求刪除、停止處理或利用您的個人資料。
6. 您得選擇是否提供相關個人資料予本案蒐集、處理及利用，惟您若選擇不提供，或只提供部份/不完全/不真實/不正確個人資料予本組承辦單位，或提供後向本組承辦單位請求刪除部分或全部個人資料，或您所提供的個人資料，經檢舉或發現不足以確認您的身分真實性或其他個人資料冒用、盜用等情形時，導致本組承辦單位無法進行必要之審核及處理，可能導致無法順利參與本計畫甄選，亦有可能造成緊急事件無法聯繫及甄選結果無法送達等事項，並影響您後續相關權益。本組承辦單位有權停止提供對您的業務處理，若有不便之處尚請見諒。
7. 為維護您的權益，本組承辦單位將採行適當之安全維護措施以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

<報名表請雙面列印>